

設計・試作サービス	回路試作機関				材料・プロセス機関							ネットワーク機関														
	東北大	東大	豊技大	広島大	北大	NIMS	科学大	名大	京大	阪大	九大	千歳 科技大	山形大	筑波大	産総研	早大	電通大	北陸 先端大	信州大	名工大	豊田 工大	分子研	JAEA	QST	奈良 先端大	香川大
CMOS回路設計	○	○	○	○																						
アナログ回路設計	○	○	○	○																						
デジタル回路設計	○		○	○																						
MEMS		○	○	○					○						○											
トランジスタ設計・試作	○		○	○	○	○	○	○	○					○	○			○				○				
フォトニクス	○		○	○		○			○																	
シリコン光導波路	○		○	○			○		○																	
混載LSI設計・試作・評価		○	○	○																						

加工サービス	回路試作機関				材料・プロセス機関							ネットワーク機関														
	東北大	東大	豊技大	広島大	北大	NIMS	科学大	名大	京大	阪大	九大	千歳 科技大	山形大	筑波大	産総研	早大	電通大	北陸 先端大	信州大	名工大	豊田 工大	分子研	JAEA	QST	奈良 先端大	香川大
CVD成膜			○	○	○	○		○	○						○					○	○					
ALD成膜				○	○	○			○						○											
多層配線形成	○		○	○					○																	
FIB加工	○				○	○		○	○		○			○				○								
エッチング			○	○		○		○	○								○									
ナノインプリント									○																	

評価サービス	回路試作機関				材料・プロセス機関							ネットワーク機関														
	東北大	東大	豊技大	広島大	北大	NIMS	科学大	名大	京大	阪大	九大	千歳 科技大	山形大	筑波大	産総研	早大	電通大	北陸 先端大	信州大	名工大	豊田 工大	分子研	JAEA	QST	奈良 先端大	香川大
パワー半導体評価				○				○	○					○	○	○										
MOSFET評価			○	○			○	○	○					○	○	○		○								
電気特性評価	○		○	○		○		○	○			○		○	○	○						○				
X線分析				○	○	○			○		○								○	○		○		○	○	
X線光電子分光(XPS)				○		○		○			○			○	○			○		○		○			○	
分光分析				○	○	○		○	○		○			○	○			○		○		○		○		
ラマン分光						○					○	○													○	
透過型電子顕微鏡(TEM)	○					○		○	○	○	○							○							○	
走査型電子顕微鏡(SEM)	○			○		○		○	○		○							○							○	○
原子間力顕微鏡(AFM)				○		○		○	○									○								
レオロジー評価													○													
界面評価				○																			○			